

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

**持續關連交易**  
**修訂二零二三年華虹集團框架協議的銷售交易年度上限**

茲提述本公司日期為二零二二年十二月三十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司與華虹集團訂立的二零二三年華虹集團框架協議，自二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日(包括首尾兩日)為期一年。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年華虹集團框架協議，現有華虹集團銷售交易年度上限為18,100,000美元。

鑒於新能源及電動汽車的快速發展，該等行業的終端用戶於二零二三年對集成電路及晶圓的需求增長高於預期。因此，本集團二零二三年對華虹集團公司的集成電路及晶圓銷售額超出了本公司的預測。本公司預計將於今年剩餘時間內收到華虹摺芯的更多訂單。因此，董事會認為，根據二零二三年華虹集團框架協議，現有華虹集團銷售交易年度上限將不足以滿足截至二零二三年十二月三十一日止年度的預期交易金額。因此，本公司擬將該上限變更至21,100,000美元。

於本公告日期，華虹集團為本公司的主要股東。因此，華虹集團及華虹集團公司(包括華虹摺芯)為本公司的關連人士及二零二三年華虹集團框架協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年華虹集團框架協議項下經修訂華虹集團銷售交易年度上限的各個適用百分比率均高於0.1%但低於5%，故二零二三年華虹集團框架協議項下擬進行的銷售交易僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

## 背景

茲提述該公告，內容有關(其中包括)本公司(代表本集團)與華虹集團(代表華虹集團公司)訂立日期為二零二二年十二月三十日的二零二三年華虹集團框架協議，自二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日(包括首尾兩日)為期一年，據此，(其中包括)本集團已同意向華虹集團公司銷售半導體產品(包括晶圓及集成電路)，作為本公司一般業務過程的一部分。

鑒於新能源及電動汽車的快速發展，該等行業的終端用戶於二零二三年對集成電路及晶圓的需求增長高於預期。因此，本集團二零二三年對華虹集團公司的集成電路及晶圓銷售額超出了本公司的預測。本公司預計將於今年剩餘時間內收到華虹摺芯的更多訂單，從而增加向華虹集團公司銷售的年度交易金額。為此，董事會認為，根據二零二三年華虹集團框架協議，現有華虹集團銷售交易年度上限將不足以滿足截至二零二三年十二月三十一日止年度的預期交易金額，因此應相應上調該上限。

除下文所述修訂銷售交易年度上限外，二零二三年華虹集團框架協議的條款並無任何變動或修訂，其主要條款載於該公告「1.1二零二三年華虹集團框架協議的主要條款」一節。該公告「1.2銷售交易的定價基準」一節所載的二零二三年華虹集團框架協議項下銷售交易的定價基準亦維持不變。

### 修訂截至二零二三年十二月三十一日止年度的華虹集團銷售交易年度上限

#### 過往交易金額及現有華虹集團銷售交易年度上限

下表載列截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及於二零二三年一月一日起至二零二三年十月三十一日止期間向虹日及華虹摺芯銷售的過往交易金額：

(單位：千美元)

	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 (經審核)	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 (經審核)	截至 二零二三年 十月三十一日 止十個月 (未經審核)
交易金額			
虹日	3,376	3,342	1,741
華虹摺芯	6,404	9,711	13,670
合計	<b>9,780</b>	<b>13,053</b>	<b>15,411</b>

於二零二三年一月一日起至二零二三年十月三十一日止期間，根據二零二三年華虹集團框架協議向華虹集團公司銷售的金額約為15,411,000美元，約佔現有華虹集團銷售交易年度上限（即18,100,000美元）的85.14%。

於本公告日期，尚未超過截至二零二三年十二月三十一日止年度的現有華虹集團銷售交易年度上限。

### **經修訂華虹集團銷售交易年度上限**

本公司建議截至二零二三年十二月三十一日止年度的華虹集團銷售交易年度上限上調至21,100,000美元。

### **經修訂華虹集團銷售交易年度上限的釐定基準**

於達致經修訂華虹集團銷售交易年度上限時，董事已考慮以下各項因素：

- (i) 根據二零二三年華虹集團框架協議於二零二三年向華虹摯芯及虹日銷售產品的過往銷售交易金額及交易量；
- (ii) 本集團預計於二零二三年剩餘時間內自華虹摯芯及虹日收到的相關半導體產品的估計訂單量；
- (iii) 本集團處理上述預期訂單的產能；及
- (iv) 半導體市場的總體情況以及新能源及電動汽車等關鍵行業的發展情況。

### **修訂華虹集團銷售交易年度上限的理由及裨益**

鑒於新能源及電動汽車的快速發展，該等行業的終端用戶於二零二三年對集成電路及晶圓的需求增長高於預期。因此，本集團二零二三年對華虹集團公司的集成電路及晶圓銷售額超出了本公司的預測。於二零二三年十月三十一日，約85.14%的現有華虹集團銷售交易年度上限已使用。本公司預計將於今年剩餘時間內收到華虹摯芯的更多訂單，從而增加向華虹集團公司銷售的年度交易金額。

因此，董事會認為，根據二零二三年華虹集團框架協議，現有華虹集團銷售交易年度上限將不足以滿足截至二零二三年十二月三十一日止年度的預期交易金額，因此應相應上調該上限。該年度上限的提高使本集團能夠進一步利用新能源及電動汽車行業對半導體產品的激增需求。這亦符合本集團的擴張計劃，其「8英寸+12英寸」公司戰略的重點之一為汽車行業。

董事（包括獨立非執行董事）認為(i)二零二三年華虹集團框架協議及經修訂華虹集團銷售交易年度上限的條款屬公平合理；(ii)二零二三年華虹集團框架協議的條款乃按一般商業條款或更佳條款訂立，且其項下交易乃並將繼續於本集團一般及日常業務過程中訂立；及(iii)二零二三年華虹集團框架協議及修訂華虹集團銷售交易年度上限的條款符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，華虹集團為本公司的主要股東。因此，華虹集團及華虹集團公司（包括華虹摺芯）為本公司的關連人士及二零二三年華虹集團框架協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年華虹集團框架協議項下華虹集團銷售交易年度上限的各個適用百分比率均高於0.1%但低於5%，故二零二三年華虹集團框架協議項下擬進行的銷售交易僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

截至本公告日期，概無董事於上述交易中擁有重大權益。除張素心先生、唐均君先生及孫國棟先生根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》須放棄投票外，概無董事須於董事會會議上放棄投票。

## 有關訂約方的資料

### 本公司

本公司主要專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝製造平台。

## 華虹集團

華虹集團為一個高科技工業集團，主要專注於集成電路製造、先進集成電路製造工藝研發、集成電路系統集成及應用服務、電子元器件銷售及海外風險投資。有關受二零二三年華虹集團框架協議規管的其他華虹集團公司交易的詳情，請參閱該公告。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

香港，二零二三年十二月一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

**非執行董事：**

孫國棟

葉峻

**獨立非執行董事：**

張祖同

王桂壩，太平紳士

葉龍蜚